

**Specifications:**

1. Electrical:
  - 1.1 Current Rating: 1.8A/contact terminal
  - 1.2 Voltage Rating: 30V DC
  - 1.3 Contact Resistance: 50 milliohms Max
  - 1.4 Dielectric Withstanding Voltage: 300 V AC AT Sea Level
- 1.5 Insulation resistance: 100MEGA ohms MIN
2. Mechanical:
  - 2.1 Connector Mate and Unmate Force
    - Mate force: 3.0kgf (Max)
    - Unmate force: 0.7kgf (MIN)
  - 2.2 Durability: 5000 cycles
3. Material:
  - 3.1 Housing:
    - Hing Temperature Thermoplastics,
    - U1 94V-0 LCP Black
  - 3.2 Contact C5191-EH
  - 3.3 Shell: H65 EH0.3MM
4. PLATING:
  - 4.1 Contact: Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails
  - 4.2 Shell: Nickel 50u~Min Plated.

REV.	ECN NO	LOCATIONS	DESCRIPTION	DATE

PART NO: A01SBXXXXXX1-067	MATERIAL
MODEL NO: XX	FINISH:
UNIT: MM	COLOR:
SIZE: A4	DR: 黄彬
TOLERANCE UNSPECIFIED	CHK: 张伟
.x 0.25	APP: 罗小春
.xx 0.15	
.xxx 0.10	
Ang. 2'	

深圳市韩下电子有限公司	
TITLE:	HX USB-MICR XNJ ZB
DWG NO:	A067
SCALE:	5:1
DATE:	
REV:	A



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd  
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

Micro USB

规格型号 Part No:

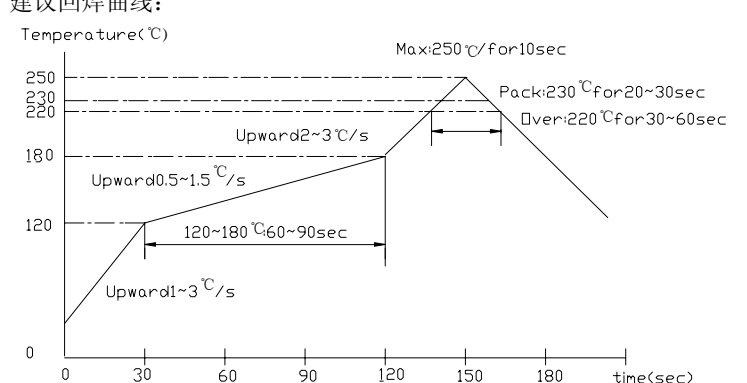
HX USB-MICR XNJ ZB

#### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191, 镍底, 接触部位镀金 1 $\mu$ "			
1.3. 外壳部分: H65 EH, 外壳镀镍底 60 $\mu$ " ,			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1.8Ampere			
2.2. 使用温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	50m $\Omega$ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100M $\Omega$ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	300V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.0kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	0.7kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 5000 次参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 <sup>-6</sup> 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C锡炉中浸泡 5 $\pm$ 0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于 85 $^{\circ}$ C的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于-40 $^{\circ}$ C的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于温度为 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50m $\Omega$ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C, stays at 120°C for 60~90 seconds, then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, stays at 180°C for 2~3 seconds, then rises at 2~3°C/s to 230°C, stays at 230°C for 20~30 seconds, reaches a peak of 250°C for 10 seconds, then falls at 2~3°C/s to 220°C, stays at 220°C for 30~60 seconds, and finally falls to 180°C.</p>